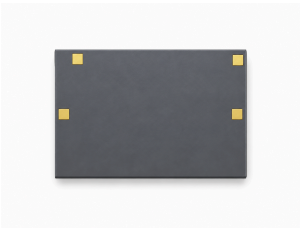
Die amplificatore di potenza GaN MMIC, 8000–12000 MHz

LCI-PA-8000-12000-PS29T è un amplificatore di potenza GaN MMIC in die non incapsulato per 8000–12000 MHz. Supporta il funzionamento CW e impulsato.

Valori della tabella RF: Potenza di uscita satura: 29 dBm (tipico); Guadagno di potenza: 14 dB (tipico); Efficienza di potenza aggiunta: 15 % (tipico). Condizioni di prova RF: TA = +25 °C; Vd = +28 V. Dimensioni del die: 1.95 × 1.35 × 0.08 mm.



Caratteristiche RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Frequenza operativa	f	8000	-	12000	MHz
Guadagno di potenza	Gp	13	14	-	dB
Planarità del guadagno di potenza	ΔGp	-	±0.5	-	dB
Potenza di uscita satura	Psat	-	29	-	dBm
Efficienza di potenza aggiunta	PAE	-	15	-	%
Guadagno per piccoli segnali	S21	-	16	-	dB
Planarità del guadagno per piccoli segnali	ΔS21	-	±0.5	-	dB
VSWR di ingresso	VSWR(in)	-	1.5	2	-

Polarizzazione DC e correnti

TA = +25 °C

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Tensione di drain	Vd	-	28	-	V
Corrente di drain a riposo	Id	0.16	0.17	0.19	A
Corrente dinamica di drain	Idd	0.16	0.17	0.19	A

Valori limite

Valori limite; non sono punti di lavoro normali.

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Tensione drain-source massima	Vd	-	-	32	V
Potenza di ingresso massima	Pin	-	-	18	dBm
Temperatura massima del canale	Top	-	-	225	°C
Temperatura di stoccaggio	TSTG	-65	-	150	°C

Dimensioni del die

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni del die	1.95 × 1.35 × 0.08	mm
Tolleranza del profilo in pianta	±100 (Solo profilo in pianta; la tolleranza dello spessore non è specificata.)	µm

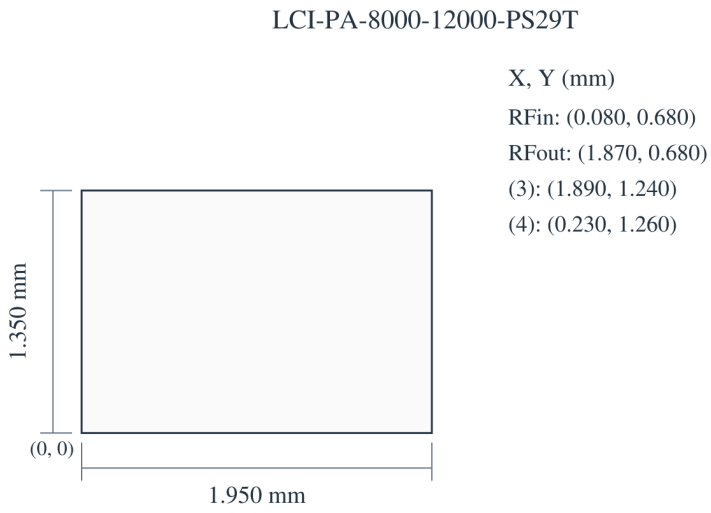
Pubblicazione corrente · 1.8 · 2026-11-12. Aggiornamento della descrizione o dei contenuti editoriali. Sostituisce la revisione 1.7.

Dimensioni dei pad di bonding

Simbolo: 1 RFin; Dimensioni (µm): 100 × 100. Simbolo: 2 RFout; Dimensioni (µm): 100 × 100. Simbolo: 3 Vd1; Dimensioni (µm): 100 × 100. Simbolo: 4 Vd2; Dimensioni (µm): 100 × 100.

Disegno dimensionale meccanico

Profilo e coordinate quotate in mm. Il disegno serve come riferimento dimensionale. Per la fabbricazione e il wire bonding occorrono disegni completi.



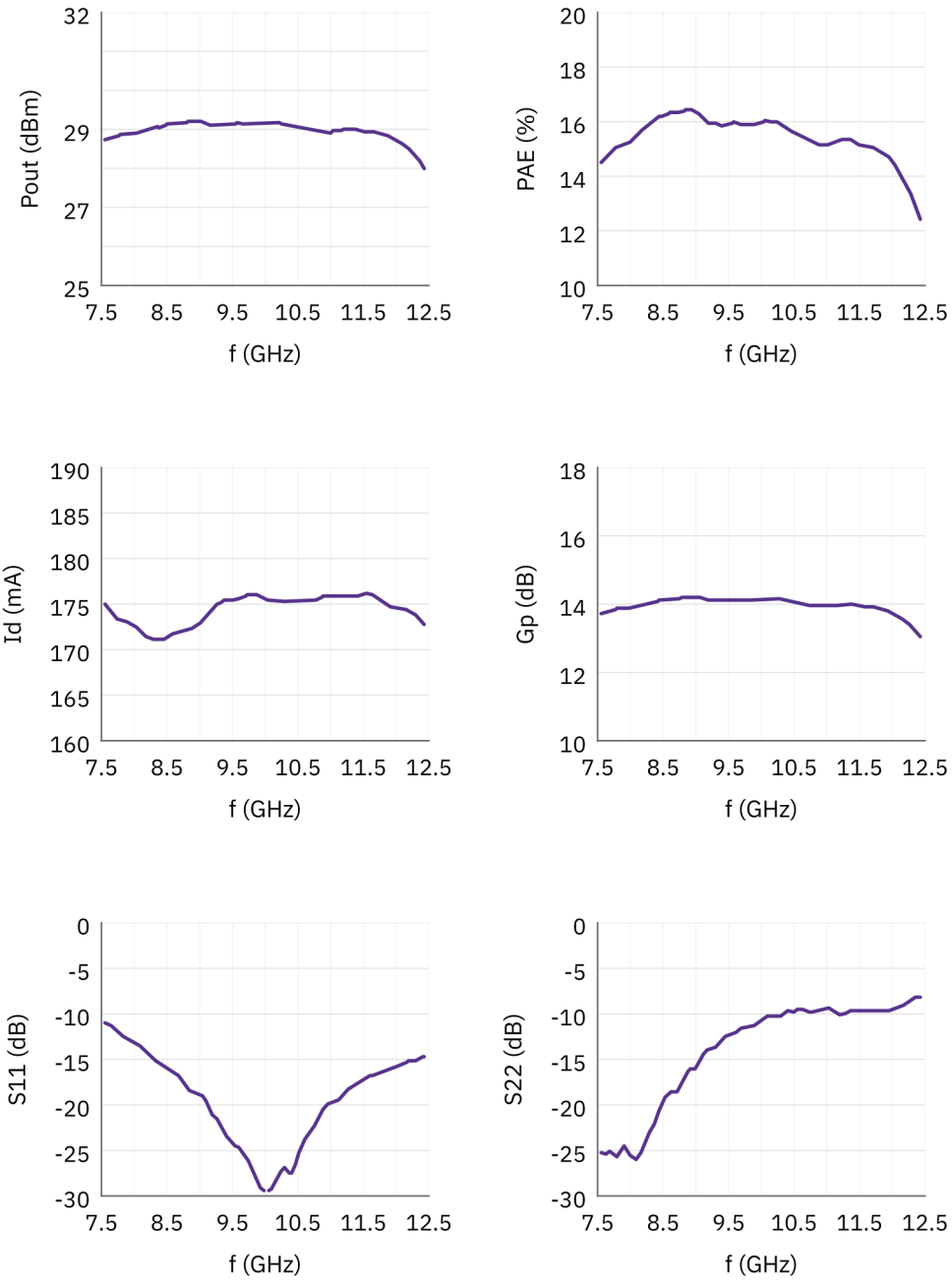
1.950 × 1.350 × 0.080 mm
X, Y: ±0.100 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

Curve di prestazione

Ogni grafico delle prestazioni si riferisce alle condizioni operative indicate nella figura.

Potenza di uscita; Efficienza di potenza aggiunta; Corrente di drain; Guadagno di potenza; Adattamento d'ingresso; Adattamento d'uscita.

Note della figura: TA=+25°C; Vd=28V. I valori letti sono approssimativi.



Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L'offerta approvata e la documentazione d'ordine definiscono la configurazione fornita.